

甬矽电子（宁波）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-009

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（<u>电话会议</u>）
参与单位名称及人员姓名	详见附件
时间	2025 年 8 月
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、CTO 徐玉鹏先生；财务总监、副总经理金良凯先生；董事会秘书、副总经理李大林先生
投资者关系活动主要内容介绍	1、2025 年上半年公司整体经营情况？ 2025 年上半年，随着全球终端消费市场持续回暖，产业链去库存周期基本结束，叠加 AI 应用场景不断涌现，集成电路行业整体景气度回升明显。2025 年上半年，得益于海外大客户的持续放量和国内核心端侧 SoC 客户群的成长，公司实现营业收入 201,028.74 万元，同比增长 23.37%，其中第二季度单季度同比增长为 17.93%，环比增长约为 12.62%，创造了公司单季度营收的历史新高。实现归属于上市公司所有者的净利润 3,031.91 万元，较上年同期增长 150.45%。毛利率方面，上半年公司整体毛利率达 15.61%，其中第二季度单季度毛利率达 16.87%，环比增长 2.68 个百分点，与去年第四季度基本持平。 固定资产方面，今年上半年公司在建工程转固约 12 亿，当期固定资产折旧金额大约为 4.5 亿。

	期间费用方面，在持续扩产的情况下，公司毛利率依旧稳步回升，公司在产品结构和成本管控方面的优势也逐步凸显，今年上半年的管理费用率从去年同期的 8% 下降到 6.61%，财务费用率从去年同期的 6.07% 下降到 5.15%，规模效应进一步显现。 研发投入方面，公司持续投向先进封装领域，今年上半年研发投入同比增长 51.28%，占比营收 7.07%。 产品结构方面，公司各产品线的营收都有所增长，QFN、FC 和晶圆级产品的增长速度较为突出，FC 和晶圆级封装产品是公司二期项目主要投资方向，今年上半年晶圆级封装整体营收超过 8,500 万元，同比增速超过 150%。上半年 SiP 类产品营收占比约 40%，QFN 营收占比约为 38%，FC 产品营收占比约 15%，晶圆级封装营收占比约 4%。 客户结构方面，海外客户上量较快，营收占比接近 25%，同比增长超过 130%。 从应用领域来看，AIoT 占比接近 70%，增速超过 30%，PA 和安防各占比约为 10%，PA 整体营收占比略有下滑，运算和车规产品合计占比 10% 左右，其中车规产品增速较快。 新产品布局方面，公司在 2.5D 产线的进展整体较为顺利，目前在与客户做产品验证。技术储备方面，公司目前已打造 HCOS 系列封装平台，为公司后续发展奠定技术基础。 2、从稼动率方面展望公司未来的营收增长情况？ 从稼动率来看，公司目前稼动率较为饱满，预计下半年整体营收环比向上。 3、公司未来毛利率趋势？公司的稳态毛利率水平？
--	---

	影响毛利率的因素主要包括三方面：价格、产品结构以及稼动率。价格方面，目前封测行业价格处于相对稳定的状态；产品结构方面，公司先进封装产品占比持续提高，将会继续对毛利率产生正向影响；稼动率方面，公司晶圆级封装产能持续爬坡，随着这部分稼动率的提升，未来会持续对毛利率起到正向提升作用。 公司理想的稳态毛利率约 25%~30%。 4、海外客户营业收入占比提升趋势？ 基于目前政策环境，海外客户有寻求供应链本土化的考量。随着与现有海外客户的深入合作以及新的海外客户的拓展，未来海外营收增速预计将会超过公司整体营收增速，海外营收占比会有所提升。 5、公司 2.5D 先进封装进展？ 公司 2.5D 封装已于 2024 年四季度完成通线，目前正在积极与客户进行产品验证。 6、公司在 AI 领域的业务布局和客户开拓情况？ 基于 AI 对先进封装需求场景的持续涌现，公司结合目前云侧和端侧 AI 的封装需求，积极推进 2.5D 封装方案，公司在持续与客户对接相关需求。 7、公司主要大客户情况以及大客户营收占比趋势？ 目前公司前十大客户包括各细分领域的龙头设计公司以及台系头部设计公司，未来大客户营收占比会持续提升，客户集中度将进一步提高。 8、今年整体资本开支规划？ 公司已审议的 2025 年资本开支规模在 25 亿元以内，较 2024 年保持稳定，主要投向包括现有产品线产能扩张、晶圆级封装及 2.5D、FC-BGA 等先进封装领域。 9、下半年下游应用领域景气度展望？
--	---

	从下半年来看，AIoT 领域需求增长相对比较确定，客户提供的 Forecast 也较为乐观。 10、公司今年上半年 QFN 产品营收增速较快，这部分增量主要是由哪些下游应用领域带来的？ QFN 应用范围较为广泛，以成熟制程为主，导入速度较快，今年上半年的增量主要来源于两家台湾大客户优先导入的 AIoT 产品。 11、公司目前相对前沿的先进封装技术？ 公司坚定践行技术创新战略，以前瞻性布局切入先进封装领域，基于自有的 Chiplet 技术推出了 FH-BSAP（Forehope-Brick-Style Advanced Package）积木式先进封装技术平台。涵盖 RWLP 系列（晶圆级重构封装，Fan-out 扇出封装）、HCOS 系列（2.5D 晶圆级/基板上异构封装）、Vertical 系列（晶圆级垂直芯片堆栈封装）等，精准适配 Fan-out（FO）、2.5D/3D 先进晶圆级封装等多元化先进封装技术需求。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 8 月 28 日